



NXP, 마이크로컨트롤러에 NFC 기술 통합해 IoT 애플리케이션의 스마트 태깅 혁신

- NFC와 마이크로컨트롤러 기술을 통합한 LPC 8N04 출시
- 다양한 태깅/프로비저닝 애플리케이션 상에서 에너지 하베스팅 및 무선 통신 구현

2017년 11월 1일 - NXP 반도체는 MCU 기반 32비트 ARM® 코어텍스®-M0+ LPC 800 시리즈에 새롭게 LPC8N04 MCU를 추가했다. LPC8N04 MCU는 에너지 하베스팅(energy-harvesting) 기능과 통합 근거리 무선 통신(NFC) 인터페이스를 제공한다. 비용 효율적인, 단거리 양방향 무선 통신에 대한 급증하는 수요를 충족하도록 최적화되었다.

점차 많은 스마트폰에 NFC 판독 기술과 풍부한 그래픽 디스플레이가 탑재되고 있다. 이러한 추세는 iOS 및 안드로이드 기반 애플리케이션 개발자들의 오픈 생태계와 결합되면서 NFC 기술 사용은 기존 탭 기반 결제(tap-to-pay)를 넘어서는 수준으로 나아가고 있다. 개발자들은 LPC8N04 MCU를 사용하면 시스템을 진단하고 환경 조건을 활용하는 광범위한 솔루션을 신속하게 실행할 수 있어, 사용자들에게 한층 스마트한 태깅 경험을 제공할 수 있다. 또한 유연한 통신 모드가 추가되어 기기 프로비저닝, 구성 및 맞춤화 등을 통해 LPC8N04 MCU 기반 에지 노드에 데이터를 전송할 수 있다.

NXP 마이크로컨트롤러 사업부 수석부사장 겸 총괄 제프 리즈는 "NXP는 전 세계 마이크로컨트롤러 시장에 우수한 기술을 도입해 혁신을 이끌어 왔다. NFC 기술을 탑재한 LPC8N04 MCU는 NXP가 일궈온 시장 혁신 역사의 연장선에 있다. 소비자를 비롯해 산업용 IoT 애플리케이션에 새로운 파장을 일으킬 NFC 기술을 널리 보급하게 되어 기쁘게 생각한다"고 말했다.

LPC8N04 MCU의 주요 특징은 다음과 같다.

- 4가지의 유연한 전력 모드를 갖춘 ARM 코어텍스-M0+ 코어
- 32KB의 통합 플래시, 8KB의 S 램, 4KB의 EEPROM 탑재
- 다양한 태깅 / 프로비저닝 애플리케이션을 지원하고, 에너지 하베스팅 기능을 갖춘 A 타입의 NFC/RFID ISO 14443 통신
- 오차 범위 +/- 1.5°C의 정확성을 갖춘 통합 온도 센서
- 두 개의 시리얼 인터페이스와 12 GPIOs를 갖춘
- 1.72~3.6V 전력 하에서 작동 가능하며, -40°C에서 +85°C까지의 온도를 견딜 수 있음
- 저비용, 소형 QFN24 패키지

보다 자세한 정보는 www.nxp.com/LPC8N04에서 만나볼 수 있다.



출시 안내

LPC8N04 MCU 는 MCUXpresso, Keil 그리고 IAR IDEs 와 호환 가능하고, 사용이 간편한 코드 예제를 갖춘 LPC8N04 개발 보드(OM40002)의 지원을 받는다. LPC8N04 MCU 는 현재 샘플링 단계에 있다. NXP 는 유통업체와 제휴를 통해 여러 톨과 기술 지원 및 완전한 레퍼런스 설계를 갖춘 MCU 를 2018 년 1 월에 시연한 후, 신속하게 출시하여 전체 유통 채널에 공급할 예정이다.

www.nxp.com/LPC 에서 LPC 를 사용해볼 수 있으며, NXP 가 어떻게 세계를 재구상하고 있는지 엿볼 수 있다.

NXP 반도체 소개

NXP® 반도체(나스닥: NXPI)는 더욱 편리하고 안전하며 더 나은 삶을 위한 첨단 솔루션을 개발하여, 안전하게 연결되는 스마트 월드를 만들고 있다. NXP는 임베디드 애플리케이션용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로서, 시큐어 커넥티드 카, 엔드 투 엔드 보안 및 프라이버시, 스마트 커넥티드 솔루션 분야의 혁신을 주도하고 있다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 33개 이상의 국가에서 31,000명의 직원을 고용하고 있다. 2016년 매출은 미화95억불이다. NXP 관련 뉴스는 www.nxp.com에서 찾아 볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그 (<http://blog.naver.com/nxpkor>) 에서도 NXP 관련 정보를 확인할 수 있다.